



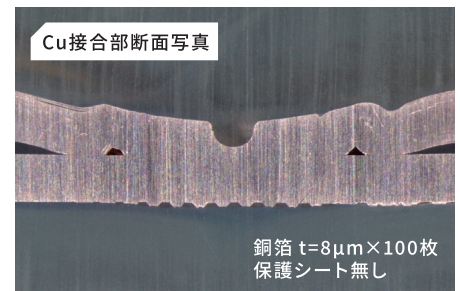
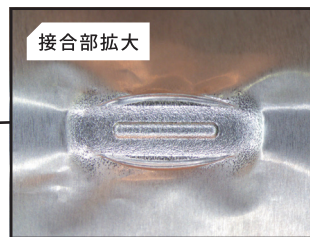
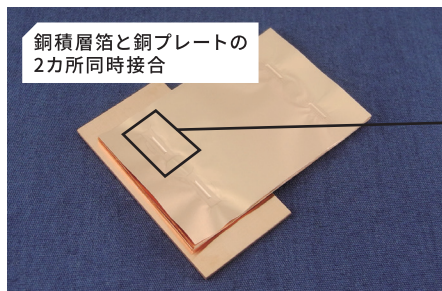
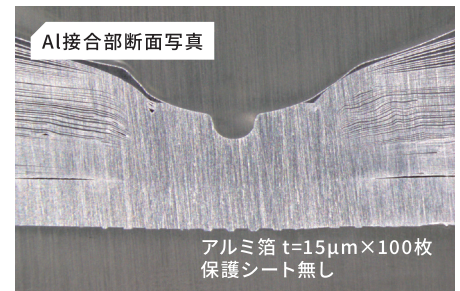
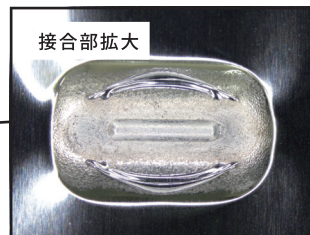
Patented

Application

Bonding ボンディング

リチウムイオン電池 電極の接合

更に進化したMSBでLIB積層箔100枚以上の複数ヶ所 同時接合



クリップ合金接合/Clip-Ingot Bonding

CIBのツールの先端形状は丸みを帯びておりエネルギーを集中できます。これまでのメッシュツールによる接合とは異なり、傷が付かないホッチキスで綴じた様な、コンタミが発生しないソフトタッチの〈綺麗〉な接合方法です。

進化したMST/Multi-Step Tool

MSTでは丸みを帯びた先端形状が多段に重なりエネルギーがより先端部に集中し、スムーズに接合することができます。その結果接合時間を短縮でき、積層箔へのダメージをより軽減し、接合音が小さくなり、接合強度が更に増します。

Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0059A4-2022082601